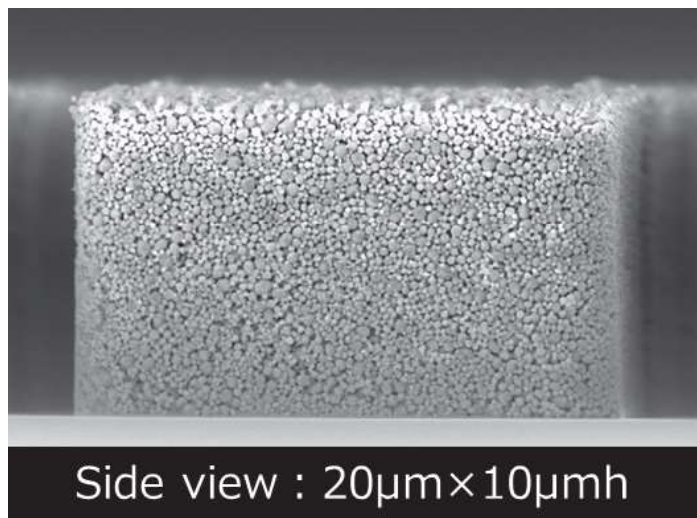




[AuRoFUSE™プリフォームWEBサイト](#) >

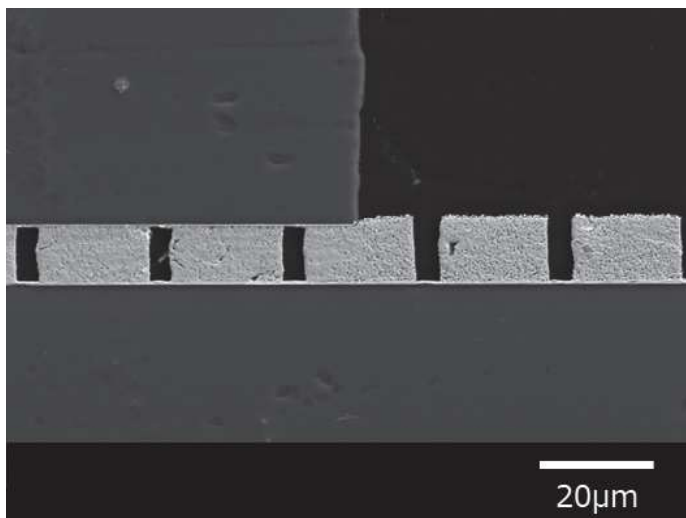
AuRoFUSE™ プリフォームのご紹介

オーロ フューズ



Side view : 20 μ m \times 10 μ m h

AuRoFUSE™プリフォームの側面



20 μ m

AuRoFUSE™プリフォーム接合後断面

AuRoFUSE™は、サブミクロンサイズに制御したAu粒子と溶剤のみで構成されたペースト状の接合材料であり、低温焼成(200℃～)で高信頼のAu-Au接合を提供できます。

さらに、接合前にAu粒子を電極形状の乾燥体(プリフォーム)とすることで、ペーストでは実現できなかった微細な高密度実装を実現しました。

特
長

- 狭ピッチの接合を実現できる
(最小実績:10 μ mサイズ、4 μ m間隙)
- 低い温度・圧力、短時間で接合が可能
(例:200℃、20MPa、10秒)
- 加圧時に水平方向への変形が少ない
- 圧縮変形能がある
- 主成分がAuのため酸化やマイグレーションが発生しづらい

Bonding material properties	AuRoFUSE™プリフォーム 200℃, 20Mpa, 10sec	Unit
Electrical resistivity	4.5	$\mu\Omega$ -cm(25℃)
Thermal conductivity	200	W / mK
Melting point	1,064	℃
Shear strength	>30	MPa(25℃)
Coefficient of Linear Thermal Expansion(CTE)	14.0	ppm
Under Barrier Metal	Au/Pt/Ti, Au/Pd/Ni	